**企业技术难题及合作意向表**

|  |  |
| --- | --- |
| **企业名称** | 中芯国际 |
| **详细地址** | 北京经济技术开发区文昌大道18号 |
| **意向合作中科院单位** |  |
| **所属产业类别** | □新一代信息技术产业 □新能源汽车与智能网联汽车产业 □生物技术与大健康产业 □机器人与智能制造产业 √其他，请说明 集成电路  |
| **企业简介** | 中芯国际是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国内地技术最先进、配套最完善、规模最大、跨国经营的集成电路制造企业，提供0.35微米到14纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务，包括逻辑芯片，混合信号/射频收发芯片，耐高压芯片，系统芯片，闪存芯片，EEPROM芯片，图像传感器芯片电源管理，微型机电系统等。 |
| **技术需求** | **技术需求名称** | **需求详情、技术基础及合作意向** |
| 制造或维修嵌入式TDI（Time Delay Integration）线扫描相机 | 需求大尺寸高端嵌入式TDI相机尺寸参数（active area 77.2mm\*18.4mm）速度快（12.8GPPS 4224 x 1024）可探测到深紫外波段（<210nm）目前工厂能验证，但具体参数实现方式不清楚，需要与研发厂商合作开发产品，可配合验证 |
| **预期取得的主要成果和效益** | 目前部分设备因为该备件宕机，需要制造替换备件或者维修备件，实现设备复机和国内自主可控 |
| **希望政府部门协调解决的问题和相关建议** | 目前联系的半导体相关厂商都没有解决方案，希望有更多与该备件相关的资源可以开发或者维修该备件 |